

2011年2月8日

LTE トリプルモードモデム 仕様概要

項目	仕様
通信機能概要	LTE access 3GPP Release 8, LTE FDD/TDD ・ LTE UE Class 3 ・ Down Link 100 Mbps and Up link 50 Mbps ・ MIMO (2x2/4x2) and RX diversity ・ Flexible bandwidth (1.4 - 20 MHz) ・ CS Fallback Voice, Single Radio VCC
	HSPA access 3GPP Release 8 ・ Down link 42 Mbps ・ HSDPA Cat. 20 (MIMO & 64QAM) ・ HSDPA Cat. 24 (DC & 64QAM) ・ Up link 11.5 Mbps ・ HSUPA Cat. 7 (16QAM) ・ HSUPA DC (Dual Cell) ・ CPC and CS over HS
	GSM access 3GPP Release 7 ・ GSM Quad Band GSM850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS1900 ・ DTM Multi Slot Class 33
インタフェース	スタンドアロンモデム時における接続インタフェース ・ USB 2.0 HS with power save functionality ・ USB mass storage for memory cards
	アプリケーションプロセッサと接続インタフェース ・ USB 2.0

項目	仕様
	<ul style="list-style-type: none"> ・ MIPI HSI v1.1 (200Mbps) ・ No Flash configuration with APE(MIPI-HSI boot)
ルネサス エレクトロニクス 及びルネサス モバイル製主要 チップセット	ベースバンドプロセッサ、RFトランシーバ IC、パワーアン プ、電源 IC
上記チップセット サンプル価格	50 米ドル(約 4100 円、1ドル=82 円)

以上